

张德远等1人赴日本公示

编号:

组团单位	机械工程及自动化		团长姓名	张德远
出访国家 (地区)	日本	经费来源	留学基金委博导短期访学	
出访日期	2016年8月20日至2016年9月9日, 共21天			
出访任务	应日本东北大学机械工程系Takahito Ono教授邀请, 赴日本东北大学交流考察, 访问东北大学主要交流微纳制造领域内仿生传感器相关技术, 了解对方研究方向与进展, 介绍北航相关研究进展, 开展学科交叉、仿生与微纳技术交叉、微观表征与微纳制造交叉技术研讨会, 探索开发新型仿生传感器, 开展合作研究并商讨及互派学生联合培养等项目。			
邀请单位	日本东北大学/ Tohoku University			
出访日程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 8月20日 离京, 经上海市, 前往并抵达日本东北大学。由日本东北大学接待方安排工作地点和办公环境。 2. 8月21日 与外方课题组见面, 并为本次合作研究工作的探讨进行工作部署。 3. 8月22日 与外方课题组共同组织研讨会, 上午由日本东北大学方面做专题报告, 主要内容为该课题组的科技成果, 下午由进行实验室成果演示。 4. 8月23日 进行研讨会, 上午我方做专题报告, 内容微观表面表征; 下午外方做专题报告, 内容MEMS加工技术的生物感知机理应用。 5. 8月24日 继续进行研讨会, 上午由我方做专题报告, 内容为仿生微纳制造技术; 下午由外方做专题报告, 内容为微纳谐振器件的非线性随机共振研究。 6. 8月25日 组织项目申请研讨, 初步拟定研究内容。 7. 8月26日 组织项目申请研讨, 拟定待申请合作项目内容细节。 8. 8月27日 组织项目申请研讨, 拟定待申请合作项目内容细节。项目来源及经费分配。 9. 8月28日 商定双方在合作申请中应完成的准备工作、撰写申请书内容分工。 10. 8月29日 拟定实验计划, 利用东北大学先进设备, 开展相关实验。 11. 8月30日 开展实验研究1(SiC仿生光子晶体结构制备), 进行SiC的等离子体刻蚀实验的前期准备(Mask制作)。 12. 8月31日 开展实验研究1(SiC仿生光子晶体结构制备), 进行SiC的等离子体刻蚀实验。 13. 9月1日 开展实验研究2(仿生非线性谐振子的制备及测试), 纳米谐振子纳米加工。 14. 9月2日 			

